



迅得機械

推動智慧工廠最佳夥伴

SAA

公司簡介



資本額

新台幣7.14億



主要業務

智能自動化整合



員工數

約1000人

公司沿革



1999

合資德國SCHMID
迅得機械成立



2004

啟動東莞廠
成立光電事業部

2007

屢獲經濟部獎項

2011

建置加工中心



2015

成立半導體事業部



2016

成立研發中心

2019

啟動楊梅廠



2021

獲准上市

2022

半導體
營收過半

年營收
5億

年營收
10億

年營收
20億

年營收
40億

SAA

經營團隊



集團董事長
官錦堃 先生

- 迅得機械創辦人
- 第38屆創業相扶獎
- 台大化工學士



集團總經理
王年清 先生

- 迅得機械共同創辦人
- 第38屆創業楷模
- 國家傑出經理獎
- MVP經理人獎
- 政大企家班
- 政大EMBA



半導體事業群總經理
黃發保 先生

- 集團發言人
- 政大企家班
- 北科大工管碩士



大陸事業群總經理
謝建平 先生

- 迅得機械(東莞)總經理
- 北大匯豐商學院碩士
- 世新傳播管理碩士
- 朝陽科大自動控制科

營運據點

大陸淮安

- 建坪約 1,700坪
- 人員數: 約20



大陸東莞

- 建坪約 4,900坪
- 人員數: 400以上



桃園中壢總部

- 建坪約 3,000坪
- 人員數: 300以上
- 載板相關產線
- 加工中心
- 研發中心



桃園楊梅

- 建坪約 1,500坪
- 人員數: 約300
- 半導體主要產線



中壢新生廠

- 興建計劃中
- 建坪12,000坪
- 半導體主要產線



迅得集團架構



主要產品



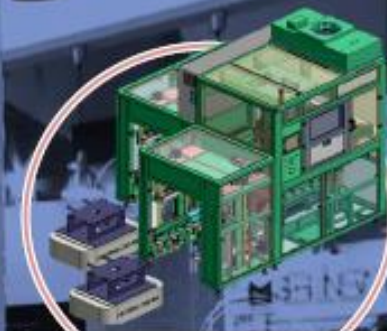
半導體製程儲存系統



全廠自動化方案



無人化搬運系統



料件自動投收設備

工業自動化方案的最佳實踐者

客戶實績

印刷電路板

th TONG HSING
同欣電子

COMPEQ

Career
嘉聯益

Unitech

半導體-晶圓/封測/IC載板

tsmc



日月光集團

winbond
We Deliver

ChipMOS
南茂科技

SPIL

UMC
聯華電子

Unimicron
欣興電子

NANYA

景碩科技

臻鼎科技集團
Zhen Ding Tech. Group

光電/其它

AUO 友達光電

Qualcomm
高通

MANTIX

FOXCONN

FLEXium

ProLogium
曜能科技股份有限公司

GLOBAL LIGHTING
TECHNOLOGIES INC.

團隊佈局

全球布局
貼近客戶
即時服務

團隊文化
資源整合
經驗傳承
組織強化



指標客戶
共同研發
製程領先

大學研發專案
建教合作專案
舉辦科技論文獎
工研院專案

產業聯盟
協同設計
專屬零件

技術優勢



模組化設計
產能效率提昇



設立技術中心
掌握前瞻技術開發



技術導向
專利超過300項



紮實文化
傳承德系工藝精神



研發量能
RD佔比33.3%

公司榮譽

榮獲潛力中堅企業、國家磐石獎
創新研究獎(2次)、小巨人獎



品質政策

至誠服務

全員以至誠
服務之態度
精進產品品質

客戶為本

提供良好品質
以達客戶滿意

積極創新

積極主動地
創新及改良設計

品質為尊

秉持良好品質
為優先，以配合
市場之成長、
滿足顧客要求

永續目標



永續經營策略

優化
人力資源發展

ECHO

- Enabling-啟動策略人才管理
- Connecting-連結績效與薪酬系統
- Hastening-加速人資系統數位轉型
- Organizing-組建企業文化與價值觀

RISC

- Risk-企業風險管理
- Info-資訊透明化
- Self-evaluation-公司治理評鑑
- Compliance-公司內部稽核

加強
公司治理

推動
E.S.G.

SCORE

- Strategic-策略性ESG
- Connectivity-連結聯合國永續目標
- Ownership-設計當責組織
- Reward-參與外部獎項競賽
- Exemplify-衡量ESG影響力

迅得機械 誠摯歡迎

迅得機械股份有限公司
Symtek AUTOMATION ASIA CO., LTD.

客戶滿意．社會責任．永續經營

SAA